# Co<sub>2</sub>FeSi/MgO/n<sup>+</sup>-SOI デバイスの室温スピン信号

石川瑞恵<sup>1,2</sup>、テイワリアジャイ<sup>1</sup>、杉山英行<sup>1</sup>、井口智明<sup>1</sup>、浜屋宏平<sup>2</sup>、手東展規<sup>3</sup>、斉藤好昭<sup>1</sup> (<sup>1</sup>㈱東芝研開セ、<sup>2</sup>阪大院基礎工、<sup>3</sup>東北大院工)

# Room-temperature spin accumulation and transport signals in Co<sub>2</sub>FeSi/MgO/n<sup>+</sup>-SOI devices M. Ishikawa, A. Tiwari, H. Sugiyama, T. Inokuchi, K. Hamaya<sup>\*</sup>, N. Tezuka<sup>\*\*</sup> and Y. Saito (Toshiba Corporate R&D Center., <sup>\*</sup>Osaka Univ., <sup>\*\*</sup>Tohoku Univ.)

#### <u>はじめに</u>

再構成可能な論理回路や不揮発メモリへの応用が期待されるスピン MOSFET [1]を実現するためには、室温スピン信号の増 大が必要不可欠である。これまで我々は Si 中でのスピン蓄積やスピン伝導を評価し[2-6]、強磁性電極のスピン分極率や MgO バリア/SOI 界面のラフネスがスピン信号に影響することを見出してきた。今回我々はこれまでの知見をもとに、ホイスラー合 金 Co<sub>2</sub>FeSi/MgO/n<sup>+</sup>-Si on insulator (SOI) 接合において大きな室温スピン信号を観測したためその内容を報告する。

## 実験方法

リンを高濃度にドープした 3inch の SOI 基板を真空中で 600°Cに加熱後、基板を冷却し た後にマグネトロンスパッタ法により Mg 層(0.6nm)を形成し、電子線蒸着法による MgO 層をウェッジ状に成膜した[7]。その後、マグネトロンスパッタ法により Co<sub>2</sub>FeSi 層(15nm) 及び Ru-cap 層(7nm)を成膜した。なお基板加熱及び成膜は全て真空一貫で行った。図 1 に SOI 基板表面の In-situ 反射高速電子回折(RHEED) 像の結果を示す。 600°C加熱した SOI 基板表面は、Si(2×1)洗浄表面となっていることがわかる。また、600°Cの加熱処理 により SOI 基板表面のラフネスが低減していることを X 線底角反射率法、断面 TEM に より確認している。この SOI 基板上に成膜した MgO 層及び Co<sub>2</sub>FeSi 層はいずれも図 1. に示すようにエピタキシャル成長していた。成膜後、リソグラフィー、RIE(Reactive ion etching)、Ar イオンミリングを用いて電極を加工し、MgO 膜厚の異なる試料を一度に作 製し、3 端子及び4 端子 Hanle、Nonlocal-MR 信号のスピン信号を室温において測定した。 さらに室温スピン信号のアニール温度依存性を評価した。



図 1. 各層での RHEED 像

### 結果および考察

図2に典型的な室温での4端子 Hanle 信号の結果を示す(アニール温度 325°C)。図2のスピン信号をフィッティング[8]した結果、41%の比較的大きなスピン分極率が得られた。これは同様に室温において測定した3端子 Hanle 信号から得られたスピン分極率とほぼ同じ値であることを確認している。当日は、これらの室温スピン信号を詳細に解析した結果とアニール温度依存性について議論する予定である。

本研究の一部は、革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)及び科学研究費補助金の支援を受けて行ったものである。

### 参考文献

S. Sugahara and M. Tanaka, Appl. Phys. Lett., 84, 2307 (2004).
 M. Ishikawa, *et al.*, J. Appl. Phys., 114, 243904 (2013).
 Y. Saito, *et al.*, J. Appl.

Phys. 115, 17C514 (2014). [4] M. Ishikawa, *et al.*, Appl. Phys. Lett. 107, 092402 (2015). [5] Y. Saito, *et al.*, J. Appl. Phys. 117, 17C707 (2015).
[6] T. Inokuchi, *et al.*, Appl. Phys. Lett., **105**, 232401 (2014). [7] H. Sugiyama, *et al.*, Solid State Commun. **190**, 49 (2014). [8] F. J. Jedema, *et al.*, Nature 416, 713 (2002).



図2. 室温での4端子 Hanle 信号